भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1343
जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है ।
11 श्रावण, 1946 (शक)

सेमीकंडक्टर चिप बनाना

1343. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेमीकंडक्टर चिप बनाने के कार्य में लगी प्रमुख सरकारी और निजी कंपनियां कौन-कौन सी हैं, उनकी स्थापित क्षमता और ट्रांजिस्टर डेन्सिटी के संदर्भ में विनिर्माण क्षमता कितनी-कितनी है;
(ख) ट्रांजिस्टर डेन्सिटी के संदर्भ में चिप बनाने के लिए स्थापित वैश्विक मानक क्या है और वर्तमान में इस संबंध में देश की क्षमता कितनी है; और
(ग) सरकार द्वारा चिप बनाने में संलग्न भारतीय उद्योगों की अत्याधुनिक संसाधनों, निधियन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण ईकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले विनिर्माण और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित चार स्कीमें शुरू की गई हैः-

क) 'भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजनाः इस योजना के अंतर्गत भारत में सिलिकॉन सीएमओएस आधारित सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए समरूप आधार पर परियोजना लागत की 50% राजकोषीय सहायता प्रदान की जाती है।
ख) 'भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजनाः इस योजना के अंतर्गत भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए समरूप आधार पर परियोजना लागत की 50% राजकोषीय सहायता प्रदान की जाती है।
ग) 'भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर्स फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओसैट सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना के अंतर्गत कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर्स (एमईएमएस सहित), फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी की स्थापना के लिए समरूप आधार पर पूंजीगत व्यय की 50% राजकोषीय सहायता प्रदान की जाती है।
घ) डिजाइन लिंक्ड इंसेन्टिव (डीएलआई) योजनाः इस योजना के अंतर्गत डिजाइन अवसंरचना सहायता के अलावा, प्रति एप्लीकेशन 15 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के तहत पात्र व्यय के 50% तक का "प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड इंसेन्टिव तथा प्रति एप्लीकेशन 30 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के तहत 5 वर्षों के निवल बिक्री कारोबार के 6% से 4% तक का डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेटिव दिया जाता है।
ङ) सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशा ला, मोहाली का एक ब्राउनफील्ड फैब के रूप में आधुनिकीकरण करने के संबंध में भी अनुमोदन दिया है।

सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत 1,48,746 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों को अनुमोदित किया गया है।

****